

 산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보도자료		
	2019년 10월 25일(금) 10시 24분부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 10. 24.(목) 오전 11시 이후 보도 가능)		
배포일시	2019. 10. 24.(목)	담당부서	반도체디스플레이과
담당과장	박종원 과장(044-203-4270)	담당자	배은주 사무관(044-203-4274)

「제12회 반도체의 날」 기념식 개최

- '종합 반도체 강국' 도약을 위한 민관 협력 다짐 -
- '시스템반도체 상생펀드' (팹리스지원) 출자 협약식 개최 -
- 반도체 산업 발전에 기여한 유공자 49명 포상 -

- 산업통상자원부(장관 성윤모)는 '19.10.24일(목) 18시 서울 드래곤시티에서 성윤모 산업통상자원부 장관, 진교영 한국반도체산업협회장(삼성전자 사장) 등 반도체 분야 산·학·연 관계자 약 500여명이 참석한 가운데 「제12회 반도체의 날」 기념식을 개최하였음
- 「반도체의 날」은 우리나라 반도체 수출이 최초로 연 100억 달러를 돌파한 1994년 10월을 기념하여 제정된 이후, 2008년부터 매년 10월에 기념식을 개최해 왔으며,
- 12회를 맞은 올해 행사는 일본의 수출규제 강화에 따른 불확실성 증가 등에도 불구하고 다시 한 번 반도체 코리아 위상을 높이기 위한 민·관의 긴밀한 협력을 다짐하는 자리로 그 의미가 깊음

< 행사 개요 >

▪(일시/장소)	2019. 10. 24(목) 18:00~20:00 / 서울 드래곤시티 백두홀
▪(참석자)	성윤모 산업부 장관, 진교영 한국반도체산업협회장(삼성전자 사장), 산업계 CEO, 반도체산업발전 유공자 등 약 500여명
▪(주요내용)	시스템반도체 상생펀드 출자 협약식, 반도체 산업발전 유공자 포상(49점) 등

- 1 -

- 성윤모 장관은 축사를 통해 국가 경제를 이끌고 있는 우리 반도체 업계의 끊임없는 노력에 감사의 뜻을 전하며, 급박한 대외환경 대응을 위해 민·관의 유기적인 협력이 다시 한 번 중요한 때임을 강조함
- 성 장관은 미·중 무역분쟁, 일본의 수출규제 강화 조치로 인한 글로벌 공급망 불확실성 증대 등의 위기를 극복하고, 우리의 취약한 부분을 보완하고 강화할 수 있도록 소재·부품·장비 공급 안정화에 더욱 매진해 줄 것을 당부하며,
- 정부는 산업계의 노력이 성공의 결실을 맺기까지 힘찬 도움닫기가 가능하도록, ①소재·부품·장비 공급 안정성 확보, ②종합 반도체 강국 도약, ③차세대 반도체 기술경쟁력 제고, ④포용과 상생의 산업 생태계 구축 등 적극적인 정책적 지원을 시행할 계획임을 밝힘
- 또한, 성 장관은, “위기를 곧 기회로 삼아 민·관이 합심하여 우리 반도체 산업의 위상을 공고히 유지하고, ‘종합 반도체 강국’을 만들어 가자”고 강조하였음
- 아울러, 오늘 행사에서는 지난 4월 발표한 「시스템반도체 비전과 전략」의 후속조치로 팹리스(시스템반도체 설계전문기업) 업계 지원을 위한 전문 펀드 조성을 위해 반도체 대기업, 금융기관 등이 참여한 ‘시스템반도체 상생펀드’ 출자 협약식도 함께 개최함
- * MOU 체결 : 삼성전자 정은승 사장, SK하이닉스 이석희 사장, 한국성장금융투자운용 성기홍 사장, 반도체협회 설계분과 위원장 손보의 실리콘웍스 대표, 반도체산업협회장 진교영(삼성전자 사장)
- 약 1,000억원 규모의 ‘시스템반도체 상생펀드’는 내실있는 팹리스에 대한 적극적인 투자 확대를 통해 시스템반도체 산업 경쟁력 제고를 위해 마련되었으며,
- 기존에 조성된 ‘반도체 성장펀드’와는 달리, ①시스템반도체 설계기업 전용, ②High-risk 투자 확대, ③중장기·대규모 투자 지원 등의 차별성을 통해 글로벌 수준의 팹리스 성장을 적극 지원하고 팹리스에 대한 투자가 원활히 이뤄질 수 있도록 펀드를 조성함

- 2 -

□ 한편, 반도체의 날을 맞아 우리 반도체 산업 발전에 각고의 노력을 기울인 **반도체 산업 유공자 49명에 대한 정부 포상도** 진행함

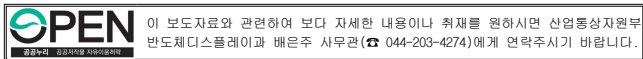
* 정부 포상(총49점) : 은탑산업훈장(1), 동탑산업훈장(1), 산업포장(2), 대통령표창(3), 국무총리표창(4), 산업통상자원부 장관표창(38)

- 반도체 장비·부품 국산화 및 글로벌 시장 진출 기반을 마련하고, 국내 협력사의 동반성장 및 상생협력에 기여한 **램리서치코리아** **서인학 대표이사**가 **은탑산업훈장**을 수상하였고,
- **동탑산업훈장**은 **5G 모뎀칩의 세계 최초 상용화**를 통해 한국 반도체 산업의 글로벌 위상을 드높인 **삼성전자 김민구 전무**가 수상함
- 산업포장은 SK하이닉스 이기화 상무, ㈜지니텍 박정권 대표이사, 대통령표창은 DB하이텍 이윤종 부사장, 한국과학기술원 박인철 교수, SK실트론 김창열 상무, 국무총리표창은 코미코 최용하 대표이사, 오로스테크놀로지 이준우 대표이사, 세메스 김성일 상무, 케이씨텍 정의훈 부사장이 수상하였음
- 이 외에도 산업통상자원부 장관표창 38명에 대해서도 시상하였음

< 반도체 산업발전 정부포상 대상자 >

구분	훈격	규모	비고
정부 포상 (47점)	산업훈장	은탑 1	서인학 대표이사(램리서치코리아)
	동탑	1	김민구 전무(삼성전자)
	산업포장	2	이기화 상무(SK하이닉스) / 박정권 대표이사(지니텍)
	대통령표창	3	이윤종 부사장(DB하이텍) / 박인철 교수(한국과학기술원) / 김창열 상무(SK실트론)
	국무총리표창	4	최용하 대표이사(코미코) / 이준우 대표이사(오로스테크놀로지) / 김성일 상무(세메스) / 정의훈 부사장(케이씨텍)
	장관표창	38	구창근 한미반도체 이사 외 37명

- 【붙임】 1. 「제12회 반도체의 날」 기념식 개요
 2. 「제12회 반도체의 날」 정부 포상자 명단



붙임 1 「제12회 반도체의 날」 기념식 개요

□ 추진 배경

- 국가 주력산업인 **반도체 산업의 성과와 위상을 홍보**하고, **반도체 산·학·연의 노고**를 격려하는 「**반도체의 날**」 기념식 개최
- * 반도체 수출 100억 달러 달성(94.10.29일)을 기념하여 제정, '08년 1회 행사 개최

□ 행사 개요

- (일시) 2019년 10월 24일(목), 18:00 ~ 20:00
- (장소) 서울 드래곤시티 백두홀(5층)
- (참석자) 산업부 장관, 반도체산업협회장 및 업계 CEO, 반도체산업 유공자 등 산·학·연 관계자 약 500 여명
- (주요내용) 시스템반도체 상생펀드 출자 협약식, 유공자 포상 등

붙임 2 「제12회 반도체의 날」 정부 포상자 명단

□ 정부 포상 : 훈장(은탑1, 동탑1), 산업포장(2), 대통령표창(3), 국무총리표창(4), 산업부장관표창(38) 등 총 49점

포상훈격	대상자	소속 및 직급	성명	공적 개요
산업훈장 (은탑)		렐리서지 코리아 대표이사	서인학	<ul style="list-style-type: none"> 반도체 장비와 부품 국산화 및 글로벌 시장 진출 토대 마련 국내 협력사 동반성장 및 상생협력에 기여 글로벌 인재양성 프로그램 지원 및 사회공헌 사업을 통한 지역사회 발전에 기여
		삼성전자주 전무	김민구	<ul style="list-style-type: none"> 메모리·비메모리반도체분야 초석 마련 국내 파운드리사업 고도화를 통한 독자생존 모델 구축(매출신장 6,666억원(15)→7,731억원(16))
산업포장 (2점)		SK하이닉스주 상무	이기화	<ul style="list-style-type: none"> Clean Chip 적출 기술 개발 등을 통해 세계 최고 수준의 원가 경쟁력을 갖춘 TEST 기술력 확보 TEST 장비 국산화 주도 및 국내 장비 업체와의 협력 개발을 통한 대·중소기업 상생 기여
		쥬지니텍스 대표이사	박정권	<ul style="list-style-type: none"> Touch 및 진동모터, 핀테크 IC 등의 기술 개발을 통해 국산화에 기여 글로벌 경쟁력을 기반으로 지속적인 수출 증대에 기여
대통령 표창 (3점)		쥬DB하이텍 부사장	이윤중	<ul style="list-style-type: none"> 국내 파운드리 사업 토대 구축을 통해 순수 파운드리 기업이 독자생존할 수 있는 비즈니스 모델 구축 세계 최고 수준의 전력반도체 개발 등 지속적인 기술개발을 바탕으로 기술 혁신 주도
		한국과학기술원 IDEC 소장	박인철	<ul style="list-style-type: none"> 산업현장 수요 맞춤형 석박사 인력 및 칩 제작 경험이 있는 실무형 전문인재 양성 등을 통해 반도체설계인력 육성에 기여 시스템반도체 분야 설계 기반 구축 지원
		쥬SK실트론 상무	김창열	<ul style="list-style-type: none"> 시설투자 및 기술 개발을 통해 시스템 반도체용 EPI Wafer 사업 기반 확보 국내 최고의 시스템반도체용 Wafer 공급 업체로서 중국 시장 개척
국무총리 표창 (4점)		쥬코미코 대표이사	최용하	<ul style="list-style-type: none"> 정년폐지, 100% 정규직 채용, 유연근무제 도입 등을 통한 좋은 일터 만들기 기여 정년, 여성, 고졸, 장애인 등 사회적 취약 계층의 채용 확대
		쥬오로스 테크놀로지 대표이사	이준우	<ul style="list-style-type: none"> 반도체 Metrology 기술력 바탕으로 Overlay 측정 장비 제작 및 생산을 통해 국산화 기반 마련 지속적인 기술혁신을 기반으로 대·중소 동반 성장을 통한 산업기반 강화
		쥬세메스 상무	김성일	<ul style="list-style-type: none"> Spinner 설비 개발 및 양산화 핵심 요소기술 관련 국내 업체 육성 및 제품 적용 확대 지원
		쥬케이씨텍 부사장	정의훈	<ul style="list-style-type: none"> Oxide CMP 공정의 ceria slurry 소재 핵심 기술 개발 및 상용화 W CMP 공정용 W Slurry 국산화 성공 및 상용화

포상훈격	소속	직급	성명	공적 개요
산업부장관표창 (19/30)	한미반도체주	이사	구창근	비전 시스템을 개발 및 적용하여 회사의 성장과 반도체 패키징 장비 국산화에 기여
	삼성전자주	수석	권오겸	시스템 반도체 제조를 위한 공정 analog 소자 특성 고도화를 통한 제품 경쟁력 향상
	한국산업기술대학교	교수	김기현	반도체 장비 분야 학사, 석사 박사 인력양성 체계를 구축 및 생산효율화 기술 개발에 기여
	에플라이드머티어리얼즈코리아주	부장	김난영	국내 부품 협력사와의 기술 제휴 추진 및 신규 시장 개척 지원에 기여
	쥬DB하이텍	수석	김대일	MCU, DRAM LDI 등 다양한 공정 및 제품을 개발하여 국내 반도체 산업 발전에 기여
	비솔머트리얼즈 한양기공주	상무	김지훈	국내 가스공급시스템의 국산화 및 반도체 라인에서의 가스 안정성을 높이는데 기여
	건국대학교	교수	김진태	해외 선진 기술의 국내 이전을 통해 국내 반도체 산업 발전에 큰 이바지를 함
	엠펙테크놀로지코리아주	수석	류창균	세라믹 flipchip BGA용 Dippable solder paste Ball attach 기술 개발에 기여
	SK하이닉스주	수석	문기일	Memory에 최적화된 기술 개발을 주도하였으며 소재/장비/공정기술의 국산화 기여
	쥬역시론	수석	박상혁	DRAM 메모리의 모든 제품군의 메모리 테스트를 개발하여 국산화 설비의 저변화에 공헌함
	쥬케이씨	파트장	박재현	반도체 공정 개발/개선을 통한 신상품 개발/수출 향상으로 반도체 산업 발전에 기여
	쥬실리콘마이트스	수석	박창섭	IFPM IC 개발에 성공함으로써 수입대체 효과 및 동 산업계의 국가경쟁력 상승에 기여
	한국전자통신연구원	책임	박형일	인체 통신 기반 터치 커어 및 캡슐 내시경 사업화 추진으로 인체통신 원천기술의 개발 기여
	피에스케이주	수석	배경호	반도체의 핵심 제어 소프트웨어의 개발 및 고도화와 반도체 제조공정 적용에 기여
	중앙대학교	교수	백광현	팹리스 기업과 공동 연구과제 수행을 통한 기업 경쟁력 향상 및 인력양성에 기여
	쥬메카로	이사	석동수	반도체 DRAM 커패시터 high-k용 ALD 전구체의 양산화 및 자동화 제조라인 구축에 기여
	쥬원익아이피에스	부장	송민기	외산 일색인 반도체 설비 시장에서 자체 소프트웨어 플랫폼과 Architecture 개발의 기여
	쥬동진세미켐	차장	신성건	반도체 공정용 Wet chemical 소재 개발 및 외산 소재를 국산화 하는데 기여
	쥬에스티아이	이사	윤병춘	한국 CCSS장비의 기술력 극대화 및 반도체 장비 수출 증대에 크게 기여

포상훈격	소속	직급	성명	공적 개요
산업부 장관표창 (11/30)	㈜엘오티베콤	상무	이상길	• 건식진공필프의 개발을 통해 제품 국산화와 기술 자립화 달성 및 시장 확대에 기여
	SK하이닉스㈜	수석	이성훈	• 장비 개발 프로젝트 수행 등을 통해 국내 반도체 산업의 인프라 강화에 기여
	㈜테크윈	대표이사	이전재	• PCI Motion 제어 Controller의 개발 공급으로 공장 자동화 설비의 국산화에 기여
	경희대학교	교수	장익준	• 반도체 설계 관련 우수한 연구 성과를 창출하였고, 다수의 석박사 인력 양성에 기여
	㈜넥스틴	수석	장한오	• 광학 검사 장비를 최초로 국산화 성공 및 수출을 통한 국내 반도체 산업 발전에 기여
	성균관대학교	교수	전정훈	• 반도체시스템공학 관련 교육 프로그램의 개발 및 운영 등을 통해 고급 인력 양성에 기여
	㈜가온칩스	대표이사	정규동	• 시스템 반도체 산업의 토털 시스템 솔루션 구축 등 국내 시스템반도체 산업발전에 기여
	㈜실리콘웍스	담당	정중휘	• 국내 시스템반도체 분야 초석을 마련 및 기술경쟁력 제고 및 기술보급/확산에 기여
	㈜넥스트칩	상무	정화인	• 국내 Fabless 산업 발전을 위한 시스템 반도체 활성화 방안 도출 및 반도체 산업 발전에 기여
	㈜유진테크	상무	현준진	• 장비 분야 세계 최초, 최고 핵심 원천 기술 개발로 반도체 산업 발전에 기여
	삼성전자㈜	수석	황 찬	• 패터닝 공정의 핵심 기술을 개발하여 제품 개발 속도, 메모리 시장 점유율 및 수출 확대에 기여
산업부 장관표창 (등반성장) (8/8)	㈜원익아이피에스	부장	김중환	• 반도체 메모리 Device의 개발 및 제조 기술 경쟁력 강화 활동을 통해 반도체 산업 발전에 기여
	SK하이닉스㈜	수석	김태환	• Batch ALD Nitride 장비의 국산화 및 양산화를 통해 국내업체의 기술력 향상에 기여
	㈜DB하이텍	수석	서승수	• 국내 최초로 TEL Furnace WAVES 설비 개조에 성공 하였으며, 기술 역량 강화에 기여
	㈜테스	부사장	안병대	• 반도체 전공정 핵심장비인 Hardmask 증착용 PECVD ACL 장비의 개발을 주도
	와이어이케이㈜	수석	이건호	• 반도체 검사 장비의 국산화 부품 채용에 따른 수입 대체 및 내수 활성화에 기여
	주성엔지니어링㈜	책임	조일형	• 반도체 장비 내 주요 가공 및 제어 구성품 등에 대한 부품 국산화를 증대에 기여
	피에스케이㈜	책임	최민호	• 반도체장비 소프트웨어 성능 향상 및 고객사의 VOC에 적극 대응하여 매출/수출 증대에 기여
	삼성전자㈜	수석	최삼중	• 반도체용 핵심 소재 기술 국산화 및 내재화에 기여 하였으며, 상생 협력 추진에 기여